

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML2

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Laminieren (nicht SD-relevant)

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

C-RS Pyralux AP8525E 305x457mm 0.050mm...	50200050	18	VS		A01	B00
		50				
		18	RS			
A-RS Klebefolie 3M 9460 50µm	50200608	50		2		
A-RS-FR4-ML-0.15mm-018+018-TG150-HF	50200650	150		3	A02	

Dicke nach Verpressen

B00:

270 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

320 µm

Dmin:

220 µm

Gesamtdicke über alles

425 µm

Tol+:

75 µm

Tol-:

75 µm

Dmax:

500 µm

Dmin:

350 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

300 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

350 µm

Dmin:

250 µm

Messstelle:

(15) Dicke nach Verpressen

nominal:

286 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik